

MLCC 龙头停产部分料号，苹果发布首款折叠屏产品

——电子行业跟踪报告

强于大市 (维持)

2026 年 09 月 14 日

行业核心观点:

上周申万电子指数上涨 1.30%，跑赢沪深 300 指数和创业板指数。MLCC 龙头厂商村田停产部分料号以调整产能，全力扩大先进高阶产品线，表明 AI 算力建设带动高容 MLCC 需求旺盛。此外，苹果发布折叠屏新产品，华为发布搭载全新麒麟芯片的 Mate XT 2，有望推动消费电子市场需求增长。我们认为算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如 PCB、存储、MLCC 等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注 PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。同时，AI 端侧产品功能日益强大，随着大厂新品逐步发布，有望推动消费电子市场需求回暖。

投资要点:

产业动态: (1) **MLCC**，MLCC 龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在 2026 会计年度启动产品线优化，将停产部分 MLCC 产品并扩充其他产能。本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分 GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG 与 ZRA 系列。村田意在通过终止生产低毛利或特定成熟料号，腾出产能以全力扩大先进高阶产品线，即在产能有限的情况下，优先保障利润率更高的 AI 服务器用高附加价值产品。(2) **消费电子**，苹果公司发布了全新的顶级智能手机系统芯片 A20 Pro，称其为“智能手机中最快的 CPU”。此外，苹果公司正式推出首款折叠手机 iPhone Duo，采用书本式内折设计，搭载 7.6 英寸内屏幕、5.4 英寸外屏幕。TrendForce 集邦咨询估计，2026 年 iPhone Duo 出货量约 500 万支，将可助力 Apple 在折叠手机市场取得约 24.8% 市占率。(3) **芯片**，9 月 7 日，华为三折叠家族新成员 HUAWEI Mate XT 2 非凡大师正式发布，首发搭载麒麟 9050 Pro，性能与能效双重跃升。软、硬、芯、云深度协同，整机性能较上代提升 42%。在发布会上，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东用“Super fast、Super intelligent、Super cool”介绍这颗芯片，称其为华为史上最强性能的芯片。这也是华为继 Mate 40 全球发布会之后，时隔六年再次在发布会上解读全新麒麟芯片。(4) **存储**，据 CFM 闪存市场，2026 年二季度全球 NAND Flash 市场规模持续增长，较一季度环比增长 73.1% 至 767.76 亿美元。长江存储受益于国产替代趋势和产品性价比优势在国内厂商中的应用范围不断拓展，二季度市场份额 15.0%，排名第三

行业估值: 从估值情况来看，截至 2026 年 9 月 13 日，SW 电子板块 PE (TTM) 为 65.06 倍，2019 年至 2026 年 9 月 13 日 SW 电子板块 PE (TTM) 均值为 56.84 倍，行业估值高于近年中枢水平。

风险因素: 中美科技摩擦加剧；AI 应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源: 聚源, 万联证券研究所

相关研究

三星电机获 MLCC 大订单，半导体设备市场规模稳步增长
英伟达业绩指引较为积极，三星电机调涨第四季度产品报价
长江存储 IPO 申请已获受理，高容 MLCC 交期拉长

分析师:

夏清莹

执业证书编号: S0270520050001

电话: (0755) 8322 3620

邮箱: xiaqy1@wlzq.com.cn

分析师:

陈达

执业证书编号: S0270524080001

电话: 13122771895

邮箱: chenda@wlzq.com.cn

正文目录

1 行业周观点.....	3
2 市场行情回顾.....	4
3 产业动态.....	5
3.1 MLCC: 全球龙头厂商村田停产部分料号, MLCC 订单或外溢.....	5
3.2 消费电子: 苹果发布 A20 Pro 芯片和首款折叠屏新品 iPhone Duo.....	5
3.3 芯片: 华为发布全新麒麟芯片, 采用逻辑折叠技术.....	6
3.4 存储: Q2 NAND Flash 市场规模继续增长, 长江存储全球市占第三.....	6
4 风险提示.....	7
图表 1: 申万一级周涨跌幅 (%).....	4
图表 2: 申万一级年涨跌幅 (%).....	4
图表 3: 申万电子板块估值情况 (2019 年至今).....	5

1 行业周观点

MLCC龙头厂商村田停产部分料号以调整产能，全力扩大先进高阶产品线，表明AI算力建设带动高容MLCC需求旺盛。此外，苹果发布折叠屏新产品，华为发布搭载全新麒麟芯片的Mate XT 2，有望推动消费电子市场需求增长。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。同时，AI端侧产品功能日益强大，随着大厂新品逐步发布，有望推动消费电子市场需求回暖。

中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，算力关键硬件环节需求旺盛，存储、PCB、MLCC等正处于景气扩张周期；此外，国产厂商先进技术创新突破，为AI芯片、先进封装优质厂商带来发展机遇，同时成熟领域产能扩充，有望提振上游半导体设备及材料等环节需求，带来投资机遇。

1) PCB，AI PCB行业受益于全球算力建设需求，高多层板及HDI市场需求增速相对较快，高端PCB扩产有望提振上游设备及材料需求，材料方面覆铜板供不应求推动产品涨价，设备方面曝光设备及钻孔设备等细分领域增速更高。建议关注在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商，同时主流PCB厂商加速扩产，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注覆铜板材料、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商。

2) 存储，受益于AI算力建设，存储供应持续偏紧，产品合约价格持续走高，行业整体盈利能力有望增强，同时我国存储龙头厂商积极把握行业发展机遇，市场份额跻身前列。建议关注DRAM及NAND Flash领域国产龙头厂商，在存储需求高企、供给偏紧或导致产品价格维持较高位的背景下，厂商盈利能力持续提升有望带来投资机遇。

3) MLCC，AI算力、新能源车等需求驱动高端MLCC需求快速增长，市场规模稳步提升，全球龙头厂商已调涨AI及车规产品价格，行业整体有望步入景气周期。建议关注前瞻布局高端MLCC产品的国产龙头厂商，在行业景气回升时有望具备较强盈利修复弹性。

4) 先进封装，华为发布“韬定律”，通过逻辑折叠等技术创新推动芯片性能提升，先进封装是实践的重要技术环节之一，市场规模稳步增长，且全球芯片大厂积极布局该领域。建议关注在先进封装各前沿技术领域前瞻布局的优质厂商，如在混合键合技术、玻璃基板材料、光互连封装、Chiplet技术等领域取得突破的龙头厂商。

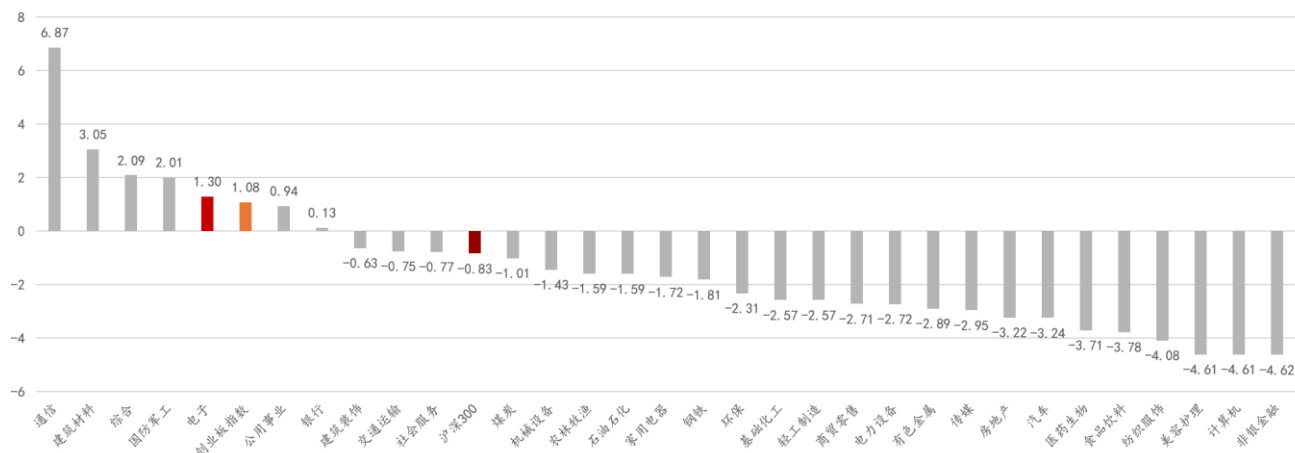
5) AI芯片，国产AI芯片市场份额快速提升，由国产芯片、国产框架、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成。建议关注AI芯片领域技术创新突破并取得下游客户认可的国产优质厂商，在国产算力加速建设背景下产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

6) 半导体设备及材料，半导体各行业优质公司积极筹备上市，存储芯片龙头公司业绩亮眼，国内晶圆厂加速推动产能扩充建设，有望提振上游半导体设备、零部件及材料需求，同时部分环节仍有较大国产替代空间。建议关注半导体设备、零部件及材料领域的优质龙头厂商，受益于下游扩产及国产替代双重增长动力，产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

2 市场行情回顾

上周，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。上周申万电子指数上涨1.30%，在31个申万一级行业中排第5，沪深300指数下跌0.83%，创业板指数上涨1.08%，申万电子跑赢沪深300指数2.14个百分点，跑赢创业板指数0.22个百分点。

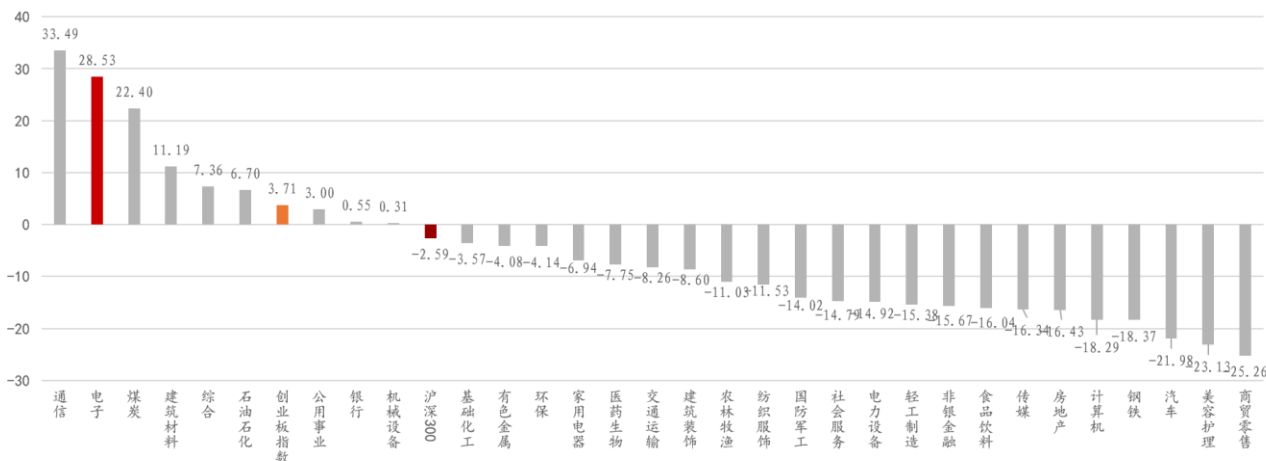
图表1：申万一级周涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

2026年初以来，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。2026年初至2026年9月13日，沪深300指数下跌2.59%，创业板指数上涨3.71%，申万电子行业上涨28.53%，在31个申万一级行业中排名第2位，跑赢沪深300指数31.12个百分点，跑赢创业板指数24.82个百分点。

图表2：申万一级年涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

申万电子行业估值略高于近年估值情况来看，截至2026年9月13日，SW电子板块PE (TTM) 为65.06倍，2019年至2026年9月13日SW电子板块PE (TTM) 均值为56.84倍，行业估值高于近年中枢水平。基于AI算力加速建设、半导体产业链景气上行等趋势利好，我们认为板块估值仍有上行空间。

图表3: 申万电子板块估值情况 (2019 年至今)



资料来源: iFinD, 万联证券研究所

3 产业动态

3.1 MLCC: 全球龙头厂商村田停产部分料号, MLCC 订单或外溢

MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知, 宣布在2026会计年度启动产品线优化, 将停产部分MLCC产品并扩充其他产能, 告知客户于2027年底前完成书面回复, 并在2028年3月底前完成最后下单, 最终出货日期为2029年3月31日。本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号, 包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。村田特别提醒, 最后下单需符合最小订购量(MOQ)与包装数量限制, 且除非发生品质问题, 否则不接受取消订单或退货, 在最后下单截止日后也不再接收任何订单。公司表示, 此举为稳定整体MLCC供货架构并改善技术支持体系, 重新调整产能配置。村田意在通过终止生产低毛利或特定成熟料号, 腾出产能以全力扩大先进高阶产品线, 即在产能有限的情况下, 优先保障利润率更高的AI服务器用高附加价值产品。村田高附加价值MLCC的交货期已从此前的8至10周, 急剧拉长至20至26周以上, 因此逐步停产常规型MLCC产品。(来源: 科创日报)

3.2 消费电子: 苹果发布 A20 Pro 芯片和首款折叠屏新品 iPhone Duo

苹果公司发布了全新的顶级智能手机系统芯片A20 Pro。这款新处理器在最新苹果iPhone发布会上首次亮相, 这也是新任首席执行官约翰·特纳斯(John Ternus)主持的首场发布会。A20 Pro将为新款可折叠iPhone Duo以及iPhone 18 Pro和Pro Max提供支持。这款全新的SoC芯片配备了6核CPU, 其中包含两个苹果的超级核心(速度比上一代提升20%), 以及四个带有神经网络加速器的能效核心。苹果公司将其称为“桌面级”处理器, 也是“智能手机中最快的CPU”。(来源: 集微网)

Apple(苹果)正式推出首款折叠手机iPhone Duo, 采用书本式内折设计, 搭载7.6英寸内屏幕、5.4英寸外屏幕。TrendForce集邦咨询估计, 2026年iPhone Duo出货量约500万支, 将可助力Apple在折叠手机市场取得领先地位。TrendForce集邦咨询预估, 2026年全球折叠手机出货量约2,020万支, 较2025年微幅成长0.5%。若排除Apple的贡献, 2026年安卓品牌合计出货量仅约1,520万支, 年减逾20%, 主因是零部件成本大幅度上涨, 各品牌出货多持平前一年或出现下降。在此情况下, 预估Samsung(三

星)出货量约710万支,市占率35.1%;Huawei(华为)出货量约500万支,市占率24.8%。对Apple而言,iPhone Duo整合Apple Intelligence与Siri AI,支持自然语言对话、个人情境理解及App内操作。折叠大屏幕若能与AI及多任务界面深度结合,将有机会由单纯的硬件差异化,转变为承载AI应用的新界面。这也意味着,折叠手机下一阶段的竞争,除了更薄、更轻与更低折痕之外,如何创造不同于传统直板手机的AI使用体验,也将成为市场能否进一步扩大的关键。(来源:TrendForce集邦咨询)

3.3 芯片: 华为发布全新麒麟芯片, 采用逻辑折叠技术

9月7日,华为三折叠家族新成员HUAWEI Mate XT 2非凡大师正式发布,首发搭载麒麟9050 Pro,性能与能效双重跃升。软、硬、芯、云深度协同,整机性能较上代提升42%。在发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东用“Super fast、Super intelligent、Super cool”介绍这颗芯片,称其为华为史上最强性能的芯片。这也是华为继Mate 40全球发布会之后,时隔六年再次在发布会上解读全新麒麟芯片,新机Mate XT 2则是首部完整采用逻辑折叠技术的手机。工艺节点没有跨代,性能却在跃升,芯片效能的提升从此多了一条路径。

何庭波此前表示,新麒麟芯片“是第一个完整采用逻辑折叠技术的芯片”。她打过一个形象的比喻,逻辑折叠就是“把城市的一个区域‘叠’到另一个区域上面,两个区域间根据逻辑关系安装几百万台电梯,这样直达的距离不会太远,也节约了时间,还可以提供更多的功能”。在不更换工艺节点的前提下,等效晶体管密度得到提升。关键路径随之缩短,互连的寄生电阻与电容下降,信号传播更快、能效更高。新麒麟芯片的效能跃升,正来自这里。据介绍,麒麟9050 Pro在计算、图形与AI等方向同步升级。计算侧,超快灵犀CPU配合方舟引擎,大文件加载速度更快,多个应用并行运行时表现更流畅。图形侧,马良GPU的计算单元与缓存容量翻倍,游戏场景下能够支持5000万线的硬件级实时光线追踪。AI侧,这颗芯片行业首次在端侧支持原生盘古30B-A2B MoE全模态大模型,可离线完成本地相册整理等任务。(来源:通信产业网)

3.4 存储: Q2 NAND Flash 市场规模继续增长, 长江存储全球市占第三

随着AI工作负载从训练向推理扩展,企业级SSD成为存储刚需,支撑原厂NAND Flash出货量持续增长。然而,原厂对NAND Flash产能扩张态度趋于保守且结构性倾斜于DRAM/HBM,使得NAND Flash新增产能有限。2026年二季度,由于全球NAND Flash市场在AI需求的拉动下仍然存在供给缺口,原厂继续保有强劲的议价权,带动产品平均售价(ASP)大幅增长,且价格涨幅显著跑赢出货量增长。量价共振下,二季度原厂NAND Flash销售收入环比均延续增长态势。据CFM闪存市场分析,2026年二季度全球NAND Flash市场规模持续增长,较一季度环比增长73.1%至767.76亿美元。

具体来看,三星二季度NAND ASP环比上涨67%-69%且NAND bit出货量创历史新高,驱动NAND Flash销售收入环比增长65.7%,市场份额27.5%,排名稳居第一;SK海力士二季度企业级SSD营收环比翻番以及321层先进技术产品持续放量带动整体NAND Flash销售收入环比增长89.1%,市场份额18.5%,排名第二;长江存储受益于国产替代趋势和产品性价比优势在国内厂商中的应用范围不断拓展,二季度NAND Flash销售收入环比增长69.1%,市场份额15.0%,排名第三;铠侠二季度产品ASP环比大幅上行且BiCS8 FLASH产能占比突破50%,推动NAND Flash销售收入环比增长73.5%,市场份额14.4%,排名第四;美光虽然二季度(2026年3月-2026年5月)NAND bit出货量仅实现中个位数环比增长但ASP却环比大涨80%带动NAND Flash销售收入环比增长99.0%,市场份额13.0%,排名跃居第五;闪迪二季度已实现QLC产品出货并确认相关收入,整体NAND Flash销售收入环比增长50.7%,市场份额11.7%,排名第六。

展望三季度，消费类客户需求持续疲软，AI对企业级产品的需求仍将成为原厂NAND Flash销售收入的主要支柱。北美和国内市场需求存在分化现象：北美AI算力红利持续释放将继续支撑客户的旺盛采购需求，而国内受CSP自研盘应用持续深化和服务器供应链齐套性问题等扰动影响，采购动能相对放缓。在此背景下，预计原厂将继续把有限的产能向服务器市场和北美客户倾斜。（来源：CFM闪存市场）

4 风险提示

中美科技摩擦加剧；AI应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场